

[首页](#)[60周年历程](#)[中国力学大会](#)[个人中心](#)[活动首页](#) > [正文](#)

MS008 新型电子材料及封装结构力学性能研究（负责人：姚尧）

2017-01-13 17:24:08

负责人：

姚尧联系人：

龙旭 xulong@nwpu.edu.cn议题：

本研讨会旨在讨论新型电子材料的热-电-力学性能，以及新一代微电子封装结构在多相耦合荷载作用下的可靠性。研究主要在以下几个方面：

- 新型电子材料的热-电-力学性能，力学理论、数值计算模型及实验研究；
- 新一代微纳米电子封装、TSV封装、3D封装等在热-电-力多相耦合荷载作用下的工作性能、可靠性分析及工艺优化；
- 其他新兴电子材料（如石墨烯、硅烯、碳纳米管、金属玻璃等）在复杂荷载作用下的力学性能，宏观形变机制与其微观结构之间的关系。